

[11] Unexamined Japanese Utility Model Publication No. S57-103862

[43] Date of Publication of Application: June 26, 1982

[51] Int. Cl.³ B 41 N 1/24

G 03 F 7/12

5 H 05 K 3/12

3/40

[54] Title of the Device: SCREEN PRINTING PLATE FOR FILLING
CONDUCTOR

[21] Japanese Utility Model Application No. S55-181690

10 [22] Date of Filing: December 19, 1980

[72] Contriver: Takashi Kuroki

[72] Contriver: Tsuyoshi Fujita

[72] Contriver: Gyouzou Toda

[72] Contriver: Kuyuki Taguchi

15 [72] Contriver: Syousaku Ishihara

[71] Applicant: Hitachi, Ltd.

[CLAIM 1]

A screen printing plate for filling conductor comprising:

a solid metal screen used for filling conductor,

20 wherein a concavo-convex pattern is formed at a side, where a squeegee
starts to move, of a periphery of a printing pattern and at a squeegee side of the
screen printing plate.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

25 Fig. 1 is a sectional view of a wiring board showing a method for filling
conductor.

Fig. 2 is a view showing positional differences of printing pattern

measurements in a conventional method.

Fig. 3 shows a state of filling conductor in the conventional method.

Fig. 4 is a plan view of a screen printing plate in accordance with an embodiment of the present device.

5 Fig. 5 is an enlarged sectional view showing a concavo-convex pattern of Fig. 4.

4 screen printing plate

5 printing pattern

8, 8' concavo-convex pattern

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭57—103862

⑤ Int. Cl.³

B 41 N 1/24

G 03 F 7/12

H 05 K 3/12

3/40

識別記号

1 0 1

庁内整理番号

6715—2H

7267—2H

6332—5F

6465—5F

⑬ 公開 昭和57年(1982)6月26日

審査請求 未請求

(全 2 頁)

⑭ 導体充填用スクリーン版

⑯ 実 願 昭55—181690

⑰ 出 願 昭55(1980)12月19日

⑱ 考 案 者 黒木喬

横浜市戸塚区吉田町292番地株
式会社日立製作所生産技術研究
所内

⑲ 考 案 者 藤田毅

横浜市戸塚区吉田町292番地株
式会社日立製作所生産技術研究
所内

⑳ 考 案 者 戸田堯三

横浜市戸塚区吉田町292番地株

式会社日立製作所生産技術研究
所内

㉑ 考 案 者 田口矩之

横浜市戸塚区吉田町292番地株
式会社日立製作所生産技術研究
所内

㉒ 考 案 者 石原昌作

横浜市戸塚区吉田町292番地株
式会社日立製作所生産技術研究
所内

㉓ 出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5
番1号

㉔ 代 理 人 弁理士 秋本正実

㉕ 実用新案登録請求の範囲

導体充填に使用するソリッドメタルスクリーンにおいて、印刷パターン部の周辺のうちスキージが動き始める側の一辺に、スクリーン版のスキージ側に凹凸パターンを設けたことを特徴とする導体充填用スクリーン版。

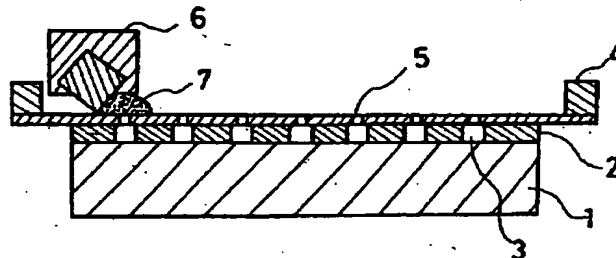
図面の簡単な説明

第1図は導体充填法を説明するための配線基板

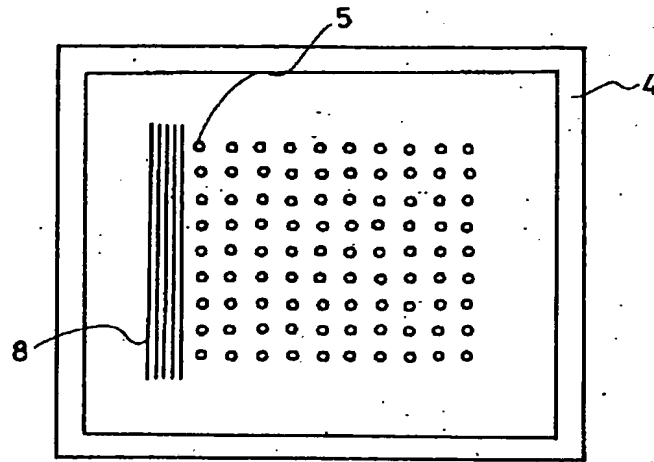
の断面図、第2図は、従来法での印刷パターン寸法の場所による違いを示す図、第3図は、従来法による導体充填の状態を示す図、第4図は本考案の一実施例を示すスクリーン版の平面図、第5図は第4図の凹凸パターン部を説明する断面拡大図である。

4…スクリーン版、5…印刷パターン、6、8…凹凸パターン。

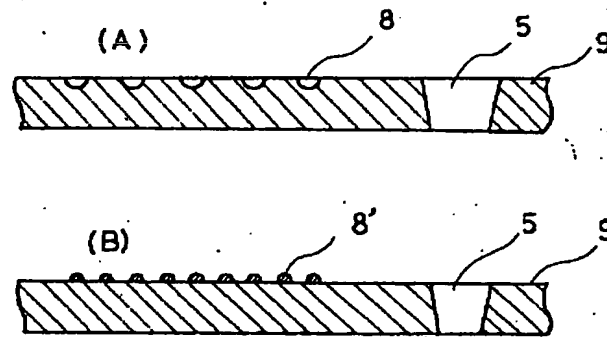
第1図



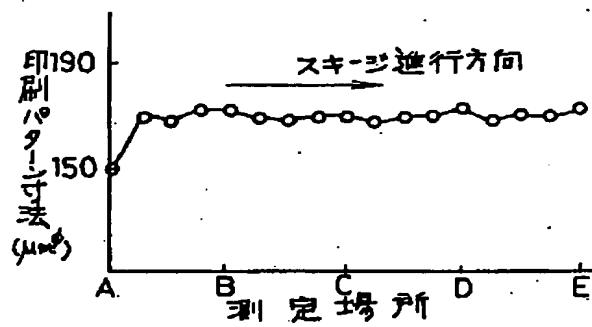
第4図



第5図



第2図



第3図

